

国泰海通证券股份有限公司

关于合肥新汇成微电子股份有限公司

2026 年度持续督导半年度跟踪报告

保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司	被保荐公司简称：汇成股份
保荐代表人姓名：赵庆辰、何立	被保荐公司代码：688403

重大事项提示

2026 年 1-6 月，汇成股份实现营业收入 95,863.18 万元，同比增长 10.67%；归属于上市公司股东的净利润 501.23 万元，同比下降 94.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,145.15 万元，同比由盈转亏，主要原因系：

（1）黄金等原材料价格同比大幅上涨，叠加一季度订单不饱和导致单位折旧、人工成本上升，毛利率下滑；（2）封测业务对应终端产品结构性变化，应用于手机特别是 OLED 产品的 DDIC 占比下滑，致使高阶测试平台稼动率降低，进而影响毛利率；（3）本期研发投入增加、股份支付费用增加、存货跌价损失增加以及美元贬值产生汇兑损失。整体而言，公司所处半导体封装测试行业未发生实质性的重大不利变化，公司经营情况稳定，不存在重大风险。

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1256 号）批复，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行股票 16,697.0656 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.88 元，募集资金总额为人民币 148,269.94 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 132,035.96 万元。本次发行证券已于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]883 号）批复，公

公司向不特定对象发行 1,148.70 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 114,870.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 114,252.79 万元。本次发行证券已于 2024 年 9 月 2 日在上海证券交易所上市。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰海通”）担任汇成股份持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 8 月 18 日至 2026 年 12 月 31 日。

在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日持续督导期内（以下简称“本持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规定，通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，现就 2026 年半年度持续督导情况报告如下：

一、2026 年半年度保荐机构持续督导工作情况

项 目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。
2、根据上市规则规定，与公司就持续督导期间的权利义务签订持续督导协议。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。	保荐机构已协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。

项 目	工作内容
4、持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。	保荐机构已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
5、对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。	保荐机构已对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。
6、督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐机构已督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。
7、上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。 保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。 上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
8、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐机构已督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
9、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项，核实上	保荐机构已持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况。本持续督导期间，上市公司不存在应披露而未披露的重大风险或者重

项 目	工作内容
市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。	大负面事项。
10、重点关注上市公司是否存在如下事项： （一）存在重大财务造假嫌疑； （二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益； （三）可能存在重大违规担保； （四）资金往来或者现金流存在重大异常； （五）上交所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。 出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查，并在现场核查结束后 15 个交易日内披露现场核查报告。	本持续督导期内，上市公司未出现该等事项。
11、关注上市公司股票交易严重异常波动情况，督促上市公司及时按照上市规则履行信息披露义务。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
12、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件； （二）资产被查封、扣押或冻结； （三）未能清偿到期债务； （四）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施； （五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项；	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。

项 目	工作内容
（六）交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	
13、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化； （二）核心技术人员离职； （三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷； （四）主要产品研发失败； （五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者； （六）交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
14、控股股东、实际控制人及其一致行动人出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对上市公司控制权稳定和日常经营的影响、是否存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险发表意见并披露： （一）所持上市公司股份被司法冻结； （二）质押上市公司股份比例超过所持股份80%或者被强制平仓的； （三）上交所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
15、督促控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	保荐机构已督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。

项 目	工作内容
16、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。	保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议，于 2026 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 12 日对上市公司募集资金存放与使用情况进行了现场检查。
17、可转换公司债券相关业务是否符合相关法律法规、上交所相关规定和募集说明书的约定，是否误导投资者或者损害投资者合法权益等。	本持续督导期间，上市公司可转换公司债券相关业务符合相关法律法规、上交所相关规定和募集说明书约定，未出现误导投资者或者损害投资者合法权益等事项。
18、保荐机构发表核查意见情况。	2026 年半年度，保荐机构发表核查意见具体情况如下： 2026 年 3 月 16 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司提前赎回汇成转债的专项核查意见》； 2026 年 3 月 19 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司授信及担保额度预计事项的核查意见》《国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司开展外汇套期保值交易的核查意见》《国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》； 2026 年 3 月 23 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司补充确认对外投资暨关联交易的核查意见》； 2026 年 3 月 26 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告》；

项 目	工作内容
	2026 年 3 月 31 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书》； 2026 年 4 月 3 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2025 年度持续督导年度跟踪报告》； 2026 年 4 月 16 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司放弃增资优先认购权暨关联交易的核查意见》； 2026 年 5 月 22 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司放弃增资优先认购权暨关联交易的核查意见》； 2026 年 6 月 17 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司对外投资设立合资公司及股权收购暨关联交易的核查意见》。
19、保荐机构发现的问题及整改情况（如有）	中国证券监督管理委员会安徽监管局于 2026 年 5 月 11 日出具《行政监管措施决定书》（〔2026〕26 号），就关联交易未及时履行审议程序、未及时进行信息披露事项，对公司采取出具警示函的行政监管措施，对郑瑞俊、闫柳、奚颢采取监管谈话、出具警示函的行政监管措施。上海证券交易所于 2026 年 5 月 14 日出具《关于对合肥新汇成微电子股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2026〕72 号），就关联交易事项对公司、郑瑞俊、闫柳、奚颢进行了通报批评。 除上述情形外，本持续督导期间，保荐机构未发现公司存在其他重大问题。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

中国证券监督管理委员会安徽监管局于 2026 年 5 月 11 日出具《行政监管措施决定书》（〔2026〕26 号），就关联交易未及时履行审议程序、未及时进行信息披露事项，对公司采取出具警示函的行政监管措施，对郑瑞俊、闫柳、奚颢采取监管谈话、出具警示函的行政监管措施。上海证券交易所于 2026 年 5 月 14 日出具《关于对合肥新汇成微电子股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2026〕72 号），就关联交易事项对公司、郑瑞俊、闫柳、奚颢进行了通报批评。

保荐机构已督促公司及相关人员就相关问题进行了全面梳理和深入分析，制定相应的整改措施并切实整改，同时，督促公司及相关人员提升公司治理和规范运作意识，加强学习、梳理证券法律法规，持续完善内部控制制度。

三、重大风险事项

公司面临的风险因素主要如下：

（一）技术风险

1、技术升级迭代的风险

随着显示面板性能需求的不断提升，显示驱动芯片技术朝着高分辨率、高帧率、高带宽、外围器件较少与功能高度集成化的方向发展。为了满足上述行业发展趋势，显示驱动芯片封测企业需通过设计及工艺的创新不断提升产品性能，为新产品的开发带来了更多的挑战，亦促进了 Bumping、COG 与 COF 等封装技术的发展。

目前公司专注于显示驱动芯片先进封测领域，主要使用 Bumping、COG、COF 等技术。如果未来公司技术升级进度或成果未达预期、未能准确把握行业发展趋势，导致未能成功进行工艺及技术升级迭代，公司市场竞争力将受到不利影响。

2、公司综合技术实力与全球行业龙头相比存在差距的风险

在集成电路封测行业中，主要公司日月光、Amkor、长电科技、通富微电、华天科技产品线均横跨封测行业多个细分领域。在显示驱动芯片封测领域，头部企业硕邦科技、南茂科技依托原有技术布局其他细分领域多年，积极开拓新的产品线。公司在封测行业其他细分领域的研发能力与技术实力仍处于积累阶段，与行业头部公司存在一定差距。

2025 年 12 月，公司通过战略投资的形式切入存储芯片封测领域。在未来，如果公司未能实现其他细分领域封装工艺的研发，弥补与行业头部公司在研发能力与技术实力方面的差距，将对公司业务拓展、收入增长和持续经营带来不利影响。

3、核心技术人才流失的风险

公司所处集成电路封测行业为典型的技术密集型行业，面临核心技术人才流失或不足、技术泄密等高科技企业共同面临的技术风险。

显示驱动芯片封测行业对技术人员专业程度、经验水平均有较高要求。目前中国大陆显示驱动芯片封测行业人才缺口较大，行业内人才争夺较为激烈、人员流动较为频繁。若公司核心技术人才流失，或无法持续培养、招揽足够的核心技术人才，将对公司的研发生产造成较大不利影响。

（二）经营风险

1、市场竞争加剧的风险

报告期内，主要来自亚洲的成熟及新兴封装测试企业持续进行产能、销售渠道和技术的拓展，显示驱动芯片封装测试领域竞争逐渐激烈。相比于集成电路封测行业头部企业，公司业务规模和综合竞争力存在一定差距，应对行业内规模竞争和价格竞争的能力仍然不足。随着行业竞争态势愈发激烈，市场竞争加剧的风险可能使公司的业务受到一定冲击，若公司不能较好地采取措施应对，可能会对公司业务开拓以及未来经营业绩产生不利影响。

2、客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大客户的销售额合计占当期销售总额的比例较高。如果未来公司的主要客户市场份额出现下滑，导致其向公司下达的订单数量下降，

或公司无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新的客户资源，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

3、供应商集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大供应商采购额合计占当期采购总额的比例较高。如果公司主要供应商生产经营发生重大变化，或交付能力未能满足公司要求，或与公司业务关系发生变化，公司在短期内可能面临关键设备和原材料短缺，从而对公司的生产经营产生不利影响。

4、其他芯片封测领域客户开拓结果不及预期的风险

公司投入大量资金持续建设研发中心、吸纳技术人才，研发凸块制造技术及车规级芯片、存储芯片等其他领域封装技术。2026 年 7 月，公司公告披露郑隆芯创计划在上海市嘉定区南翔镇投资建设“HITS 先进封装研发产业化项目”，旨在开发公司下一代先进封装及测试解决方案。如果公司未来在上述领域的客户开拓结果不及预期，有可能影响未来的业绩增长空间。

5、对外投资可能无法达到预期收益的风险

为提升综合竞争力，近年来公司开展了参与设立私募股权基金、投资联营企业鑫丰科技、与关联方共同投资设立合资公司合肥晶瑞旺布局 HITS 先进封装等一系列对外投资活动，投资规模较大，投资周期较长，受经济环境、行业政策、产业格局等不确定性因素影响，可能存在大额投资无法实现预期收益的风险。

（三）财务风险

1、毛利率波动及下滑的风险

报告期内，公司主营业务毛利率为 16.38%，同比下降 6.87 个百分点，主要系报告期内金价及汇率波动、稼动率及产品结构受终端需求影响波动，导致毛利率同比有所下滑。如果未来受显示面板产业周期波动影响，或国家产业政策调整，导致显示驱动芯片封测需求持续下滑，公司可能无法获取充足的客户订单形成生产规模效应，以及公司生产及管理能力和水平若无法适应未来发展，造成营业成本过高，将使得公司封测服务的单位成本处于较高水平；或者行业新进入者和新扩

产能增加，竞争加剧促使显示驱动芯片封装测试业务价格下降，均可能导致公司毛利率面临下滑风险。

2、存货跌价风险

报告期末，公司存货账面价值 34,318.20 万元，占期末流动资产的比例为 18.29%。公司期末存货金额较大，占比较高，并且公司存货金额可能随着公司业务规模扩大进一步增长，占用公司较多的经营资金。如果未来市场需求、价格发生不利变动，可能导致公司存货积压、跌价，公司营运资金压力增加，从而对公司经营业绩造成不利影响。

3、新增固定资产折旧规模较大风险

公司所处集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资。报告期内，公司固定资产折旧费用金额为 21,397.57 万元，较上年同期约增加 1,144.63 万元。公司新增固定资产折旧规模较大，期末在建工程的逐步转固会进一步增加固定资产的折旧规模，新增固定资产折旧将可能对公司的经营业绩产生较大的影响。如果公司未来市场及客户开发不利，不能获得与新增折旧规模相匹配的销售规模增长，则公司存在因新增固定资产折旧规模较大导致利润下滑的风险。

（四）行业风险

1、集成电路行业周期性波动风险

公司所封装测试的芯片广泛应用于智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴等各类终端消费产品。受全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，上述终端产品消费存在一定周期性，若下游终端市场需求大幅减少，将对产业链上游供应产生不利影响，若公司无法提高市场占有率，提升对客户的供应份额，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

（五）宏观环境风险

1、汇率波动风险

公司的记账本位币为人民币，公司对境外客户（以直接客户注册所在地为统计口径）销售金额占主营业务收入的比例接近 60%，境外销售及采购主要交易采用美元、日元等外币计价。报告期内，受汇率波动的影响，公司汇兑损失为 956.41 万元。如果未来境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得外币汇率大幅波动，公司有可能面临汇兑损失的风险。

2、区域贸易政策变化导致的风险

集成电路封装测试行业对原材料和设备有较高要求，公司报告期内主要生产设备和部分原材料均采购自中国境外（以日本为主，具体以设备与原材料原产地为统计口径）；同时，公司的主要客户亦为境外企业（以中国台湾地区为主）。如果未来相关国家或地区与中国的区域贸易政策发生重大变化，限制进出口或提高关税，公司可能面临生产设备、原材料短缺和客户流失等情形，进而导致公司生产受限、订单减少、单位成本增加，对公司的业务和经营产生不利影响。

3、产业政策变化的风险

集成电路产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。近年来，国家出台了包括《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》等在内的一系列政策，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面为集成电路企业提供了更多的支持，以推动集成电路行业发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力。如果未来国家相关产业政策出现重大不利变化，将对公司发展产生一定不利影响。

四、重大违规事项

中国证券监督管理委员会安徽监管局于 2026 年 5 月 11 日出具《行政监管措施决定书》（〔2026〕26 号），就关联交易未及时履行审议程序、未及时进行信息披露事项，对公司采取出具警示函的行政监管措施，对郑瑞俊、闫柳、奚颢采取监管谈话、出具警示函的行政监管措施。上海证券交易所于 2026 年 5 月 14 日出具《关于对合肥新汇成微电子股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2026〕72 号），就关联交易事项对公司、郑瑞俊、闫柳、奚颢进行了通报批评。

保荐机构已督促公司及相关人员就相关问题进行了全面梳理和深入分析，制定相应的整改措施并切实整改，同时，督促公司及相关人员提升公司治理和规范运作意识，加强学习、梳理证券法律法规，持续完善内部控制制度。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2026 年 1-6 月	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	95,863.18	86,619.31	10.67
利润总额	108.42	10,418.20	-98.96
归属于上市公司股东的净利润	501.23	9,603.98	-94.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,145.15	8,281.94	-113.83
经营活动产生的现金流量净额	20,525.46	38,652.89	-46.90
主要会计数据	2026 年 6 月末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	450,594.89	354,899.47	26.96
总资产	532,856.84	487,460.13	9.31

（二）主要财务指标

主要财务指标	2026 年 1-6 月	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	0.01	0.12	-91.67
稀释每股收益（元 / 股）	0.01	0.12	-91.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.01	0.10	-110.00
加权平均净资产收益率（%）	0.13	2.94	减少 2.81 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.29	2.53	减少 2.82 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	6.22	5.94	增加 0.28 个百分点

报告期内，公司利润总额同比减少 98.96%，归属于上市公司股东的净利润同比减少 94.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 113.83%，主要原因如下：（1）黄金等原材料价格同比大幅上涨，叠加一季度订单不饱和导致单位折旧、人工成本上升，毛利率下滑；（2）封测业务对应终端产品结构性变化，应用于手机特别是 OLED 产品的 DDIC 占比下滑，致使高阶测试平台稼动率降低，进而影响毛利率；（3）本期研发投入增加、股份支付费用增加、存货跌价损失增加以及美元贬值产生汇兑损失，进一步加剧利润下滑。

报告期内，公司基本每股收益及稀释每股收益同比均减少 91.67%；扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 110%，主要系经营业绩下降所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 46.90%，主要系黄金价格同比上涨幅度较大，公司采购原材料支付的现金增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）技术研发与新型凸块工艺创新优势

公司始终将技术创新作为发展的核心驱动力，在显示驱动芯片（DDIC）封测领域具备深厚的技术积淀。

显示驱动芯片封测行业属于技术密集型行业，公司所应用的封测技术均属于高端先进封装形式。公司拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒。公司所掌握的凸块制造技术（Bumping）是高端先进封装的代表性技术之一，通过凸块制造“以点代线”的技术创新，以几何倍数提高了单颗芯片引脚数的物理上限，进而大幅提高了芯片封装的集成度、缩小了模组体积。公司封装工艺中的玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）均使用高密度、细间距的倒装凸点互连芯片封装技术。上述工艺基于前沿的倒装芯片（FC）封装技术，结合自身生产工艺与设备进行优化，所封测的产品拥有 I/O 密度高、尺寸小、运算速度快、可靠性高和经济性佳等优势。

新型凸块工艺量产与技术迭代：面对金价上涨带来的市场痛点，公司凭借在金凸块（Gold Bumping）制程中积累的多年量产工艺经验，迅速实现铜镍金、钯金等新型凸块制程的产能建制。公司新型凸块制程在有效帮助客户降低黄金耗用量与封装成本的同时，保持了不低于传统金凸块的加工服务费水平，展现出强大的技术变现与毛利率优化能力。

（二）专业的管理团队优势

公司拥有专业的管理团队，部分核心管理成员曾供职于显示驱动芯片封装测试领域的龙头企业，具备约 20 年的技术研发或管理经验。公司管理团队对于整个行业的发展以及公司的定位有着较为深刻的认识，是一支经验丰富、结构合理、优势互补的核心团队，为持续提升公司核心竞争力和开发新工艺提供了强有力的人力资源支持。

封测行业客户需求较为多样化，不同的产品需求往往需要不同的生产工艺、技术及管理队伍相匹配，这对封测企业的生产组织能力和质量管理提出了严格的要求。在公司专业管理团队的带领下，公司致力于持续提升生产管理水平、强化质量管理，已具备业内领先的产品品质管控能力，所封装产品具有集成度高、稳定性强、体积轻薄等客户需求的品质，产品良率高达 99.90%以上，得到行业客户的高度认可。

（三）知名客户的资源优势

显示驱动芯片的封装测试厂商需要经过芯片设计公司较长时间的工艺认可，而后才能达成长期合作意向，故存在较高的供应链门槛。凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、生产一体化、不断提升的产能规模、交付及时性等，公司获得了行业内知名客户的广泛认可，已经建立了较强的资源优势。

公司与联咏科技、天钰科技、集创北方、奕力科技、瑞鼎科技、奇景光电、新相微、爱协生、云英谷等行业内知名芯片设计公司建立了稳定的合作关系，并曾获得联咏科技颁发的“最佳配合供应商奖”和“最佳品质供应商奖”，公司所封测芯片已主要应用于京东方、维信诺、友达光电等知名厂商的面板，深厚的客户资源为公司的长期发展带来源源动力。

（四）持续扩大的规模优势

显示驱动芯片设计公司选择长期合作伙伴时，着重考虑封装测试厂商是否具备足够的产能规模，是否具备大批量、高品质供货的能力。随着公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募投项目实施以及铜镍金、钯金新型凸块制程产能推出，报告期内公司产能进一步提升。同时，公司仍将视市场需求和产能搭配情况适时补充部分设备，继续利用规模优势来巩固和提高在全球行业内的竞争地位。

（五）完善的管理体系优势

公司高度重视产品质量的管控，将产品质量视为企业生存和发展的核心。公司一直致力于建立健全质量管理体系，通过了包括 IATF 16949:2016 在内的一系列国际体系认证，拥有完善的质量管理体系，这也是公司能够获得众多知名客户长期信赖的基石之一。

2024 年，公司及全资子公司江苏汇成经过严格审核已通过了汽车行业质量管理体系 IATF16949:2016 正式认证，并取得注册证书。表明公司在显示驱动芯片封装测试服务领域全面符合 IATF 16949:2016 质量管理体系的要求，在产品质量管理、持续改进及客户满意度方面达到了国际汽车行业的高标准要求，也标志着公司在车载显示领域取得了进入国内外汽车行业供应链的准入通行证。

（六）全流程统包生产优势

公司在显示驱动芯片封装测试领域具有领先地位，是中国大陆少数同时拥有 8 吋和 12 吋产线的显示驱动芯片全流程封测企业，业务覆盖了金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装完整四段工艺制程，是全球少数可以实现显示驱动芯片封装测试服务一体化的企业。公司提供的全流程服务有效提高了生产效率、缩短了交付周期、降低了生产成本，并且避免了晶圆测试与封装流程中间长距离周转而导致晶圆被污染的风险。

（七）地理与产业集群优势

公司位于中国集成电路产业中心城市合肥，合肥系“一带一路”和长江经济带战略双节点城市，也是长三角区域经济一体化重要城市。合肥市具有良好的产

业基础和经营环境，政府大力推进集成电路产业的集群发展。此外，长三角地区是我国集成电路产业集中度最高、产业链最完整、制造水平最高的区域，具有较为显著的范围经济效益，公司立足长三角有利于更贴近客户和原辅材料供应商，产生协同作用。

公司总部位于合肥市综合保税区，目前合肥的集成电路产业快速发展，产业链上下游从芯片设计、晶圆制造、封装测试到配套材料设备或产成品应用等方面的企业已相对完整，公司上下游企业如晶合集成、京东方、维信诺等均落户合肥或建厂，因而公司深入产业集群之中，可以有效节省运输时间与成本，提高生产响应速度以加快产品交付，缩短供应链周期，有利于享受集成电路产业集群红利。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

公司持续加大在集成电路先进封装测试等领域的研发力度，2026 年 1-6 月研发投入达 5,965.60 万元，研发投入总额占营业收入比例达 6.22 个百分点，较上年同期增加 0.28 个百分点。公司核心技术主要集中在凸块制造、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装等环节。公司基于微间距驱动芯片凸块制造技术等实现了显示驱动芯片的高密度细间距倒装封装。高密度细间距倒装封装是实现显示屏幕全面屏、薄型化和轻量化的关键性技术，极大地促进了下游显示面板市场的发展，在显示面板整体发展中起到重要作用。公司在高端先进封装领域拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺、晶圆高精度稳定性测试技术等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒。

公司所掌握的凸块制造技术(Bumping)是高端先进封装的代表性技术之一，通过光刻与电镀环节在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的“点”接口，实现了封装领域“以点代线”的技术跨越。公司目前在显示驱动芯片领域中应用的金凸块制造工艺可在单颗长约 30mm、宽约 1mm 芯片上生成 4,000 余金凸块，在 12 吋晶圆上生成 900 万余金凸块，可现金凸块宽度与间距最小至 6 μm ，并且把整体高度在 15 μm 以下的数百万金凸块高度差控制在 2.5 μm 以内。公司通

过凸块制造“以点代线”的技术创新，以几何倍数提高了单颗芯片引脚数的物理上限，进而大幅提高了芯片封装的集成度、缩小了模组体积。

公司一直专注于高端先进封装技术，主要封装工艺为玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF），应用于显示驱动芯片封测领域，两者均使用高密度、细间距的倒装凸点互连芯片封装技术。公司上述工艺基于前沿的倒装芯片（FC）封装技术，结合自身生产工艺与设备进行优化，所封测的产品拥有 I/O 密度高、尺寸小、运算速度快、可靠性高和经济性佳等优势。公司研发的高精度晶圆研磨薄化技术可微量控制 0.1 μm 等级的抛磨技术；提出的晶圆研磨前裂片异常处理方法可有效避免晶圆材料的浪费并保障产品良率；拥有的高精度高效内引脚接合工艺结合了高精度高可靠的芯片识别与挑拣、微米级的凸块定位与键合等技术，可实现单颗芯片上数以千计的金凸块与柔性基板上对应的内引脚精准、高效键合。

随着 AI 大模型的爆发式演进，市场对高性能计算芯片的需求持续攀升。报告期内，公司投建 HITS 先进封装项目，主要采用基于有机中介层的架构，实现逻辑 SoC、DRAM、LPDDR 及 Wi-Fi 等芯片在单一封装内的晶圆级平面整合。该技术在提升整体计算性能、缩减物理尺寸及优化散热效率方面具备显著优势，能够有效契合 AI 服务器、移动设备及边缘人工智能等领域的行业发展趋势与应用需求。

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	5,965.60	5,142.65	16.00
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	5,965.60	5,142.65	16.00
研发投入总额占营业收入比例（%）	6.22	5.94	增加 0.28 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

（二）研发进展

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高画素解析驱动晶片溯源系统研发	1,100.00	256.02	1,135.59	导入量产	初步完成产品验证，实现产品高精度标记功能，芯片微米镭雕标记（或条形码/二维码），实现产品追溯辨识需求	国内领先	高阶显示驱动芯片、车载芯片等领域
2	一种应用于半导体测试设备维修吊车装置	1,500.00	339.06	1,576.38	导入量产	机台在发生需要更换配件时，可快速响应，节约维修时间；节约维修人力，可有效保护更换配件，防止二次损伤	国内领先	显示驱动芯片、新能源车载芯片测试设备等领域
3	钯金单晶圆旋转式复合药水蚀刻设备研发	1,450.00	598.91	1,034.41	项目结案	构建新一代高效复合蚀刻与液体循环管理系统，有效清除传统蚀刻工艺残留副产物，显著提升产品良率与质量一致性，同时精简制程工艺站点，优化生产链路	国内领先	显示驱动芯片等领域
4	先进封装领域一种高分辨率涂胶工艺缺陷检测 AOI 装置	800.00	365.87	1,010.72	导入量产	通过高分辨率阵面相机+线扫相机+AI 运算百分之百检测涂胶后产品，取代人工自主检查，提升产品质量	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
5	多层复合金属凸块应用于显示驱动芯片的研究	1,500.00	683.57	1,149.96	小批量试产	研发多层复合金属凸块取代金凸块制程取得价格的优势，提升产业竞争力	国内领先	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
6	薄膜覆晶封装显示驱动芯片提高内引脚键合精度的研究	1,500.00	639.02	965.97	小批量试产	提升驱动芯片精度检测覆盖率，以提升内引脚键合精度；软件功能开发提升生产效率和产品品质良率	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
7	超高长宽比芯片翘曲度管控技术	1,500.00	444.90	688.13	样品试制	设计适应更大长宽比范围的驱动芯片薄化工艺，对产品进行应力优化管控翘曲度，减少芯片后续工艺的风险，达成产品稳定生产且高良率的目的	国内领先	高阶显示驱动芯片、车载芯片等领域
8	一种专用于晶圆测试探针卡针尖清洁的等离子清洁装置之研究	1,500.00	672.43	672.43	工艺设计与开发	专用探针卡针尖等离子清洁装置样机开发，形成一套成熟、可量产的针尖清洁工艺参数体系，实现针尖各类污染物彻底清除，清洁一致性高，有效降低测试接触不良率	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
9	短脉冲激光工艺对驱动芯片的研究	800.00	196.47	196.47	工艺设计与开发	在终端应用使用过程中更贴合特性需求，透过低脉冲激光工艺加入提升产品特性，将现有激光工艺改善提升，有效推展至规格要求较严谨的高画素解析驱动芯片(OLEDDriverIC)，使面板客户端获得更稳定的品质，减少不良特性显现，尤其激光溶渣降低与产品应力表现提升	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
10	电子皮肤技术	10.00	5.15	5.15	工艺设计与开发	单膜集成 ASIC+MCU+无线，256+通道，响应 10ms，弯折 10 万次，输出结构化数据，效率提升 5 倍，国产化 COF/SOF 量产，完成原型到量产的跨越	国内领先	适配人形机器人灵巧手、中高端智能假肢、工业协作机械臂三大核心场景
11	显示驱动 IC 测试技术研发与应用	300.00	446.42	756.04	小批量试产	改变针卡的设计，大幅降低以及杜绝芯片测试过程中熔针发生率，延长针卡使用寿命，提升效率	国内领先	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
12	应用于赋能高精度金凸块性能优化的低温等离子预处理工艺研发	500.00	310.41	470.97	小批量试产	通过多物理场耦合与智能闭环控制，系统性的解决残留物、铝垫损伤等核心难题，极大地提升返工成功率	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
13	车规级高端芯片激光标识系统的研究	900.00	420.29	575.64	小批量试产	完善高端车载产品线建立与导入	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
14	高分辨率和高刷新率显示芯片散热的研发	800.00	469.82	598.45	小批量试产	新工艺研发，用于满足高分辨率、高刷新率产品特性需求	国内领先	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
15	高性能晶圆 UBM 层溅镀工艺创新与高可靠封装工艺研发	700.00	117.26	117.26	样品试制	完成高性能晶圆 UBM 层溅镀工艺创新与高可靠封装工艺研发	国内领先	显示驱动芯片等领域
合计	/	14,860.00	5,965.60	10,953.57	/	/	/	/

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况是否合规

截至 2023 年 12 月 31 日，发行人首次公开发行股票并上市的募集资金已使用完毕。

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

发行名称	2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024 年 8 月 13 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	114,870.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	617.21
二、募集资金净额	114,252.79
减：	
以前年度已使用金额	112,330.08
本年度使用金额	2,032.41
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	2.63
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	112.33
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	0.00

公司 2026 年上半年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2026 年 6 月 30 日，汇成股份控股股东扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）持有公司 17,410.36 万股股份，2026 年上半年公司控股股东持股数量未发生变化，不存在质押、冻结或减持情况。

截至 2026 年 6 月 30 日，汇成股份实际控制人郑瑞俊、杨会分别持有公司 140.00 万股股份、2,359.39 万股股份，持股数量未发生变化，不存在质押、冻结或减持情况。

截至 2026 年 6 月 30 日，汇成股份董事和高级管理人员持股情况及 2026 年上半年变动情况如下：

姓名	职务	期初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动原因
郑瑞俊	董事长、总经理	140.00	140.00	-	
沈建纬	董事	-	-	-	
洪伟刚	董事	-	-	-	
朱景懿	董事	-	-	-	
林文浩	职工代表董事、 副总经理	35.00	35.00	-	
杨辉	独立董事	-	-	-	
蔺智挺	独立董事	-	-	-	
罗昆	独立董事	-	-	-	
李咏思	独立董事	-	-	-	
钟玉玄	副总经理	15.00	15.00	-	
马行天	副总经理	15.00	15.00	-	
黄振芳	副总经理	50.00	50.00	-	

姓名	职务	期初持股数	年末持股数	年度内股份 增减变动量	增减变动原因
奚颢	董事会秘书	38.80	38.80	-	
闫柳	财务总监	12.50	12.50	-	

截至 2026 年 6 月 30 日，汇成股份董事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

经核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，上市公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项。

十二、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告、半年度报告等信息披露文件。

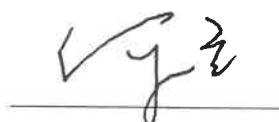
（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2026 年度持续督导半年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



赵庆辰



何立



国泰海通证券股份有限公司

2026 年 8 月 31 日